

項次	職務名稱	預計規劃的工作項目	未來工作地	需求科系
1	軟體系統設計	1. 軟體設計與文件維護 2. 通訊協議驗證與除錯 3. 產品功能驗證	台中	資電、資工、通訊、電機電子
2	演算法開發	1. 語音訊號處理技術研究 2. AI 建模與優化	台中	電機、資工、通訊、應數
3	韌體開發	1. Programming with mcu 2. Implement algorithm	台中	電機、資工
4	設計驗證	1. 新產品/材料開發驗證評估 2. 品質相關問題預防、分析與改善 3. 量產機種設計/製程變更、2nd source、ORT、客訴問題之驗證評估	台中	機械、材料、電子、電機、工業工程
5	軟體驗證	1. FW/APP 驗證相關工作評估與展開 2. 量產/延伸機種軟體相關工作驗證	台中	資訊管理、資訊工程
6	零件驗證(機構)	1. 新材料研究及材料規格審核 2. 機構料件設計驗證相關工作評估	台中	材料、物理
7	零件驗證(電子)	1. 電池芯的驗證 2. 電子料驗證及問題解決	台中	電子
8	機構設計	1. 開發音訊類新產品(耳機) 2. 研究市場產品	台中、台北	機械、航太、輪機、農機
9	聲學模擬	1. 模擬麥克風相關產品的聲學特性，包含有限元素與等效電路分析 2. 實驗以驗證模型正確度	新竹	工程科學、機械、應力、電機、化工
10	麥克風應用	1. 量測麥克風聲學性能 2. 評估客戶應用之電路或機構環境	新竹	工程科學、機械、應力、電機、電子
11	半導體封裝測試整合	1. 封測相關數據庫整理與建立 2. 聲學以及氣壓計產品，模組產品測試驗證 3. 撰寫程式，優化分析工具	新竹	機械、工程科學、應力、資管
12	系統整合	1. 自動化程式開發，包含測試程式、介面整合以及數據分析 2. 進行軟硬體整合，建立環境測試與認證之相關架設	新竹	機械、電機、應力、工科、自動控制